



ADVANCED QUALITY CONTROL BV

Slimme interacties vóór pcb fabricageproces

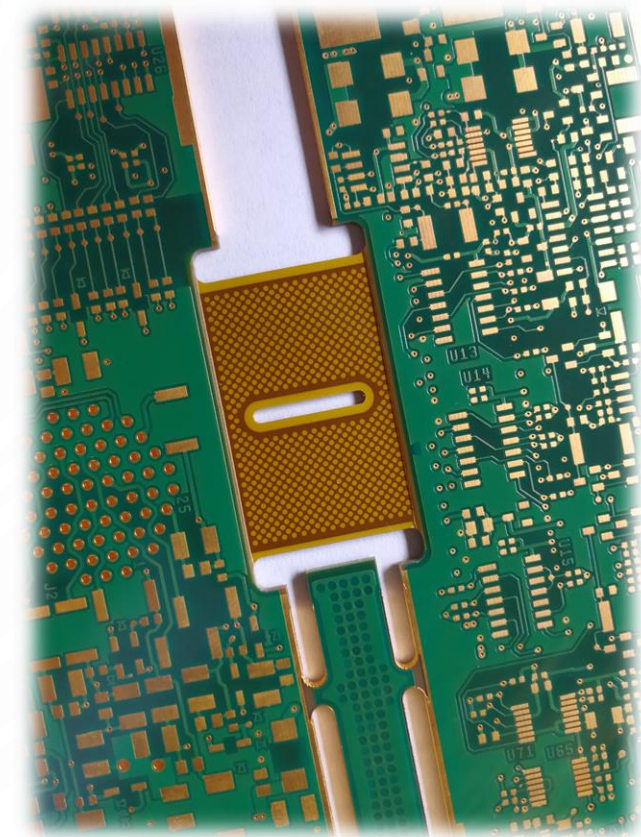
Den Bosch 12/10/2017

ADVANCED QUALITY CONTROL BV

- ❑ > 25 jaar elektronica kennis
- ❑ Diversiteit producten
- ❑ AQC productielocaties wereldwijd
- ❑ Proto types / volume aantallen
- ❑ Flexibiliteit
- ❑ Eigen laboratorium
Metallurgisch en mechanisch onderzoek.
- ❑ ISO 90001:2015 gecertificeerd



- ❑ 1 tot 80 laags printen
- ❑ Flex-rigid en flex folies, 28+ lagen
- ❑ RF technologie
- ❑ Blind/Burried HDI pcb's, koper gevuld
- ❑ Dik koper printen
- ❑ Aluminium printen
- ❑ Ultra dunne substraten
- ❑ BGA substraten
- ❑ Exotische technologieën



PRODUCT AANVRAAG / OFFERTE



- ☐ Duidelijk en complete print specificatie
- ☐ Laagopbouw
- ☐ Panalisatie beschrijving (kerven, routing.....Incl. plaats fiducials)
- ☐ Complete data pakket



Specificatie

AQC File Nr.:	16110702
Type:	Rigid
Laags:	18
Basis Materiaal:	FR-4 TG170
Eind Cu Buitenlaag:	35
Eind Cu Binnenlaag:	18
Afwerking:	Imm Ni Au
Einddikte:	2,44
Smallest Hole:	0,20
TrackGap:	100
PCB Dim Length:	393,70
PCB Dim Width:	260,35
Printen in Paneel:	0
Panel Dim Length:	0,00
Panel Dim Width:	0,00
X-Out allowed:	☐

Scoring:	☒
Routing:	☒
Soldeermasker:	Groen
Tekstopdruk:	Wit
Gold Connector:	☐
Controlled Impedance:	☒
Burried Via:	☐
Blind Via:	☐
Filled Via:	Resin Plated over
Date code:	YYWW Silk Top
UL Logo:	Silk Top
Specificatie:	IPC-2
Remark AQC1:	Imm Ni Au + Hard Au
Remark AQC2:	
Remark AQC3:	
Remark AQC4:	
Remark AQC5:	

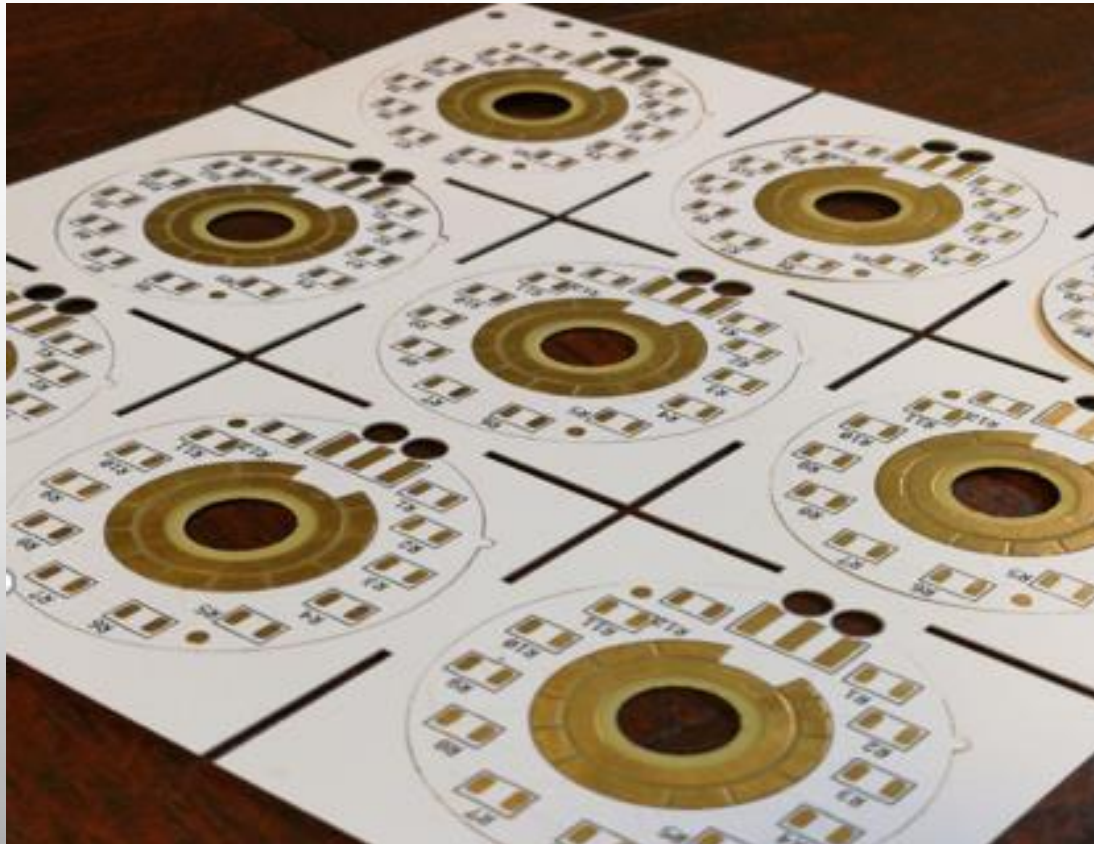
Wat kan er allemaal fout gaan of tegen zitten! Waardoor?



- ☐ Paneel setup creëren zonder component opstelling te kennen.
- ☐ Laagopbouw / impedantieberekeningen → materiaal afhankelijk
 - O.a. geen impedantie waarden gekend. Alleen opbouw volgen klant!
- ☐ Weinig achtergrond kennis applicatie.
- ☐ Materiaal voldoet niet.
- ☐ Afwerking product. Slechte keuze!
- ☐ Etc...



Push Back Technology



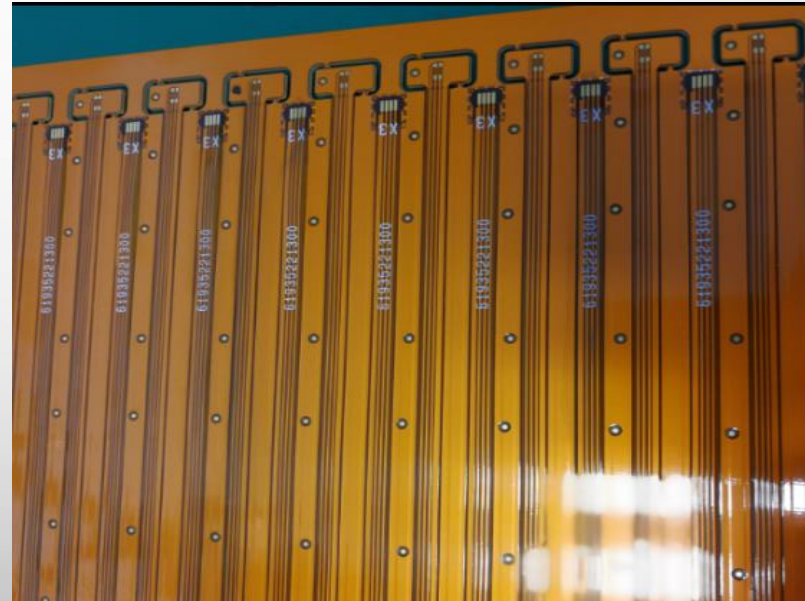
Voordeel

- Eenvoudige verwerking
- Geen nokjes of uitsteeksels

Nadeel

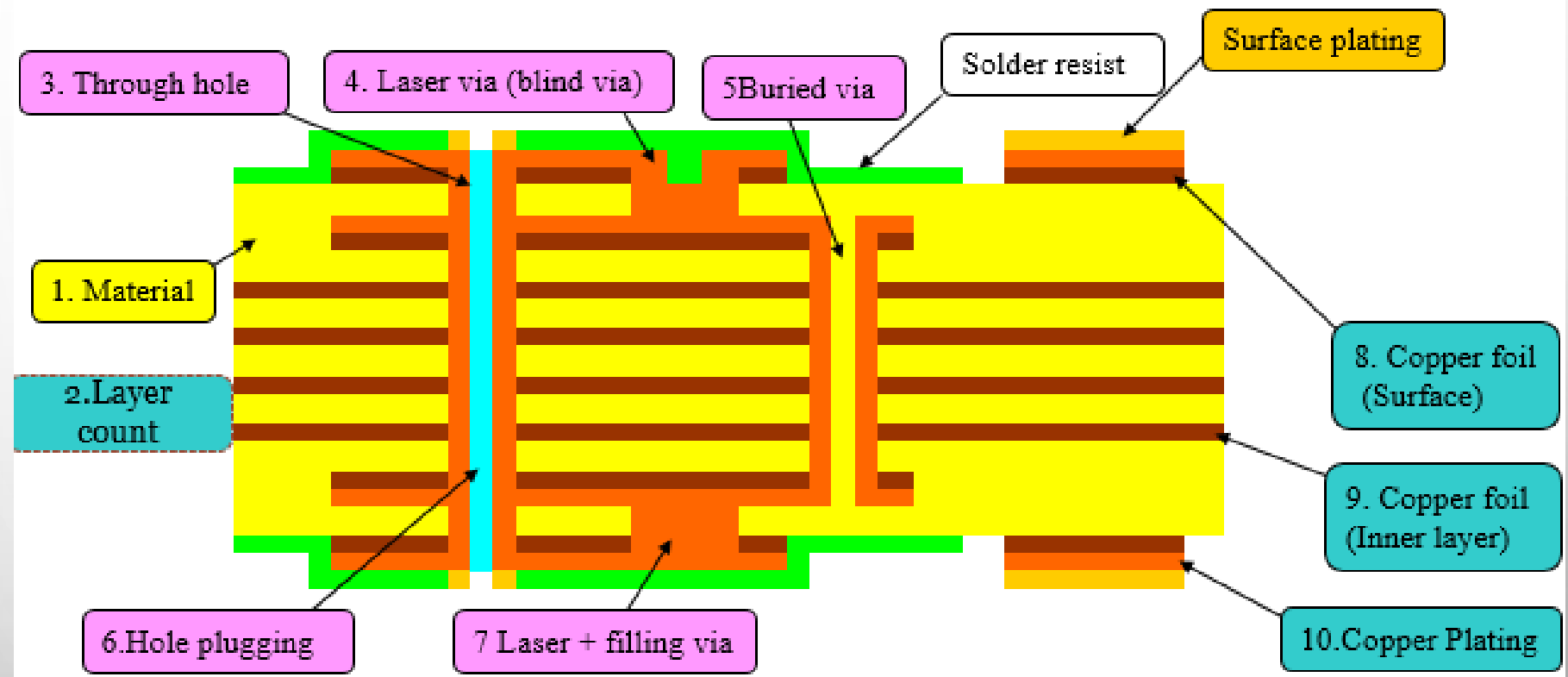
- Eenmalige kost hoog
- Enkelzijdige assemblage

Panel Flex circuit



- Combinatie FPC + FR4 carrier (inclusief 3Mtape)

LAYER STRUCTURE



- 1. Various material options
- Low Dk & Df
- High TG , Low CTE
- Halogen free
- Rohs compliance, UL certification,
- Others.

Others		
2	Layer count	2 - 10
3	Through hole	Min $\varnothing 0.15$
4	Laser via	Min $\varnothing 0.06$
5	Buried via	Min $\varnothing 0.1$
6	Hole plugging	Available
7	Laser + filling via	Available
8	Copper foil (surface)	12 /18 etc
9	Copper foil (inner layer)	18 /35/70
10	Copper plating	15

ARLON**TACONIC**

ROGERS

Nelco

KB	SHENGYI	ITEQ	isola	ventec
tuc	EMC	Panasonic	GETEK	NAN YA
HITACHI	Laird	BERGQUIST	ThinFlex 3M DUPONT	+

S

Standard
materials

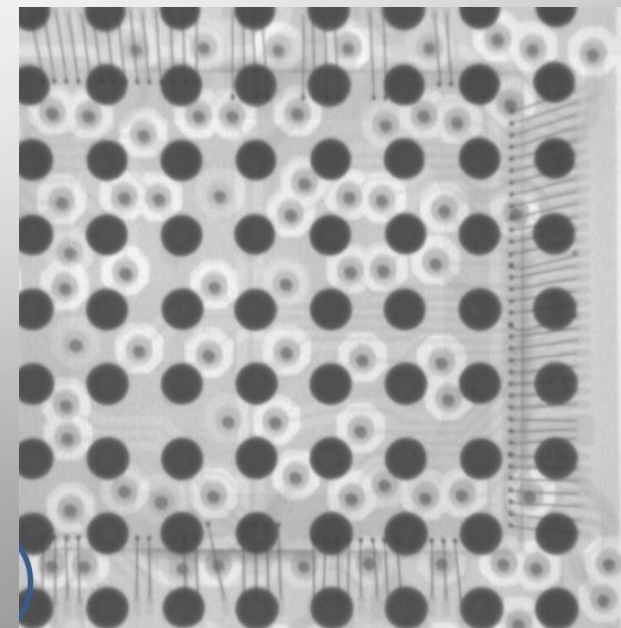
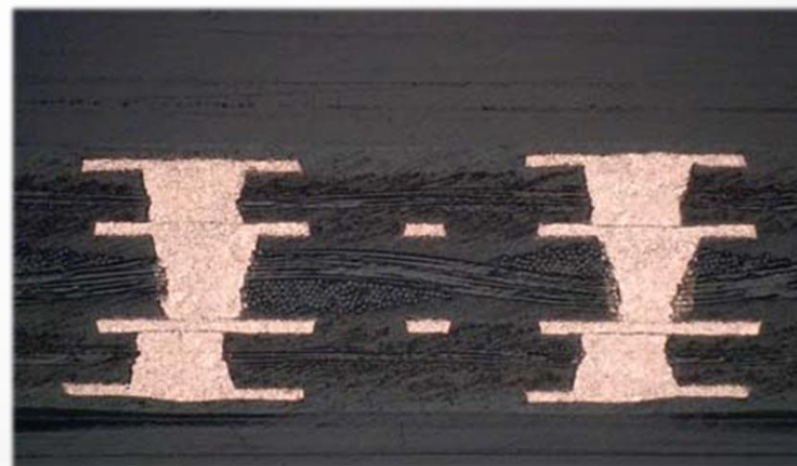
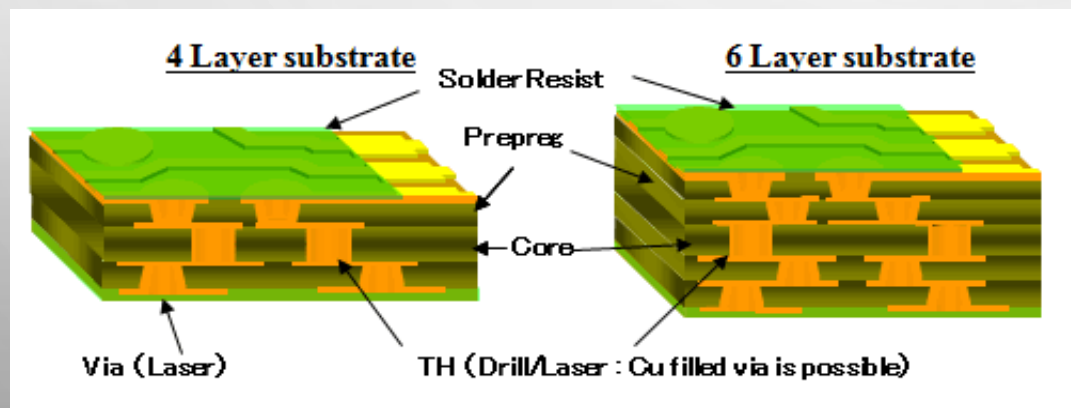
With sufficient raw
materials stock of
standingbrands,
 can offer the
best solution for
allkinds of materials.

H

igh
frequency materials

BGA SUBSTRAAT

- 4-layer,
- Material BT resin HL832 NX
- Overall thickness 0.36 +/- 0.04 mm
- Track/Gap ≥ 0.05 mm
- Smallest laser via 0.07 mm
- NiPdAu finish
- Filled copper / Stacked vias



U BENT VAN HARTE WELKOM OP ONZE
NIEUWE LOCATIE.



Zuiddijk 5
5705 CS Helmond

Industrieterrein "Hoogeind"



Bedankt allen voor jullie aanwezigheid